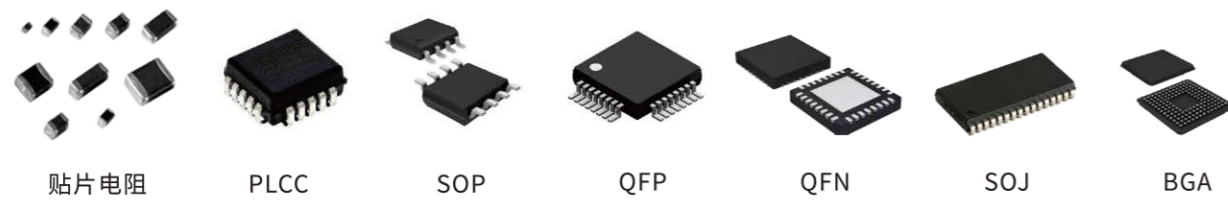


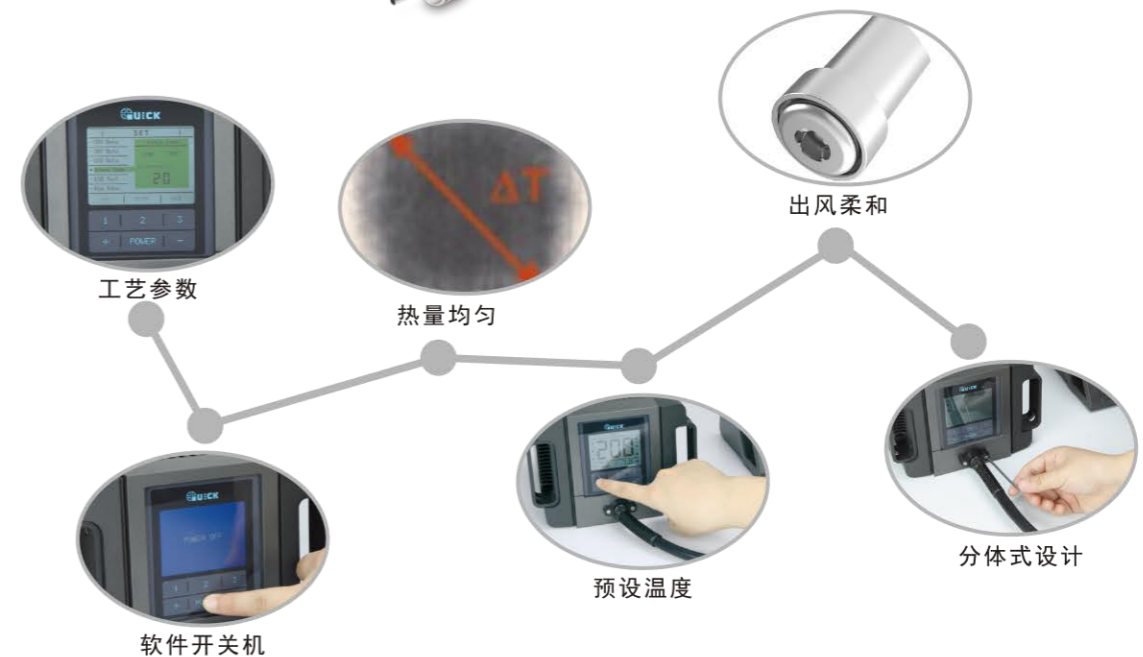
智能无铅拆焊返修台

智能无铅拆焊返修台是根据电子技术的发展与广大从事电子产品研究、生产、维修人员的需求，开发研制生产的一种高效实用的多功能产品，它采用热风加热熔锡的原理，能快速干净地拆卸焊接各类封装形式的元器件，同时采用非接触式加热，使元器件和PCB免受损伤。

随着电子技术的不断升级，元器件精密化微小化，PCB多层化，集成度更高，对于解焊返修的工具提出了更高要求。安全高效的智能拆焊返修设备应运而生，新款设备采用“多点分段可编程”技术，降低对器件的热冲击，为不同器件定制不同温度曲线；先进“行星贯通结构”，有效减小出风阻力，延长发热体寿命。自动冷却及休眠技术，在节省能源同时保护了发热体。风阻的快速插拔式固定结构能方便地调整风阻的方向，使其保持被拆焊元器件引脚的方向一致，从而能够对被拆焊元器件进行均匀加热，使得元器件引脚处的焊锡均匀受热熔化，从而提高拆焊效率。



QUICK TRI300 智能热风拆焊台



快速换装风阻



智能高效安全拆焊



风量恒定，热量充沛，效率高，特别适合一些低温拆焊和超大元器件、高耗电等特殊场合的拆焊作业。

智能锡焊
烟雾净化
解焊返修
静电防护
测试仪器
BGA返修系统

智能无铅拆焊返修台



特点



大功率设计，智能分配并有效保障热量充沛供应，功率可达1300W。



输出恒定的流量，不受风阻大小、风管挤压变形的影响。



温度可设定分段加热，预热和快速拆焊相结合，高效安全。



自动识别设计，当手柄与主机不匹配时会报警提示。



触摸按键外形美观、防水防潮、易操作、寿命超长。



快速切换3个不同温度点，满足不同产品不同焊接工艺要求。



密码锁定功能，有效保障生产工艺参数不被随意修改。



实时监测ESD接地功能，确保焊接产品静电防护安全。



更贴心的安全保护设计，应对突然的断电重启，需确认后方可加热，确保安全。



华氏摄氏两种温标模式自由切换。



触摸式即时休眠功能。



自动关机功能，降低耗材成本，节约能源。



POWER软件开关机，待机功率小，不做无用功。



0.8W 待机功耗

参数规格

产品图片			
型号	TR1300	TR1300A	TR1350
功率	1300W	1300W	1300W
工作电压	AC 220V	AC 220V	AC 220V
温度范围	100~500°C	100~500°C	100~500°C
温度稳定度	±2°C(静止空气没有负载)	±2°C(静止空气没有负载)	±2°C(静止空气没有负载)
流量	6-70L/Min	6-70L/Min	6-70L/Min
风量档位	6-70级	6-70级	10-70级
外形尺寸	214*235*159 (mm)	214*235*159 (mm)	214*235*159 (mm)
发热芯型号	H618A	H618A	H618A
按键方式	触摸式	按键控制	触摸式
重量	约5.3kg	约5.0kg	约5.3kg
分体式热风笔	√	√	√
程序快速切换	√	√	√
ESD接地监测	√	√	√
网络通讯	√	-	√
温度自动校正	-	-	√
可编程温区	-	-	√
分区多段加热	-	-	√
脚踏开关	√	-	-
用途	<ul style="list-style-type: none"> 适合多种元件的拆、焊，如：SOIC、CHIP、QFP、SOP、PLCC、SOJ、BGA、QFN 适用于热收缩、烘干、除漆、除粘、解冻、预热、消毒、胶焊接等 风量可调，适用于需要小风量和大风量加热的场合 适用于无铅热风拆焊的场合 		



智能无铅拆焊返修台



QUICK TR1100



热风柔和均匀，手柄轻巧、握持舒适，取位精准，有效保证临近器件不受热冲击，特别适合于微型CHIP元件的拆焊工作。

标配风咀

名称	规格
A1065	Ø1.5mm (0.06in)
A1066	Ø2.0mm (0.08in)
A1067	Ø2.5mm (0.10in)
A1068	Ø3.0mm (0.12in)
A1069	Ø3.5mm (0.14in)
A1070	Ø4.0mm (0.18in)



QUICK 861DW 无铅热风拆焊台



发热芯剖视图

特点

- 具有CH1、CH2、CH3三个工作通道，并且可以设置每个通道的风量、温度。
- 具有密码保护功能和按键锁定功能。
- 实时操作方便，具有磁控开关控制，手柄放置在手柄架上则立即进入休眠。
- 具有自动休眠功能，在休眠状态可以对参数进行设置。
- 传感器闭合回路，微电脑过零触发控温，功率大，升温迅速，温度调节方便且精确稳定，不受出风量影响。
- 采用无刷涡流风机，气流量可调、范围大，可以适应多种用途。
- 系统设有自动大风量冷却功能，延长发热体寿命，保护热风手柄。

规格

型号	QUICK 861DW
功率	1000W
电压	AC 220V
温度范围	100~500°C
流量(Max)	55L/Min
风量档位	1~120级
发热芯型号	H616A
标配风咀	NK1130 (φ4.4) / NK2064 (φ6.4) / NK2084 (φ8.4)
外形尺寸	189*265*141 (mm)
重量	约3.9kg

特点

- 手柄轻巧，使用倍感舒适。
- 陶瓷发热体插拔式设计，维护方便快捷。
- 采用双级增压无刷泵，风压恒定，寿命长。
- 多点温度数字校准，密码锁定功能，有效保障工艺参数。
- 静音及静电防护设计。

规格

型号	QUICK TR1100
功率	200W
工作电压	AC 220V
温度范围	100~500°C / 212~842°F
温度稳定度	±2°C (静止空气没有负载)
流量(Max)	7L/Min
风量档位	1~7级
发热芯型号	H617A
外形尺寸	190*190*135 (mm)
重量	约3.5kg

工艺参数



分体式设计



软件开关机



预设温度



智能无铅拆焊返修台



QUICK/855PG 可编程热风拆焊台



风阻转接头



真空吸笔



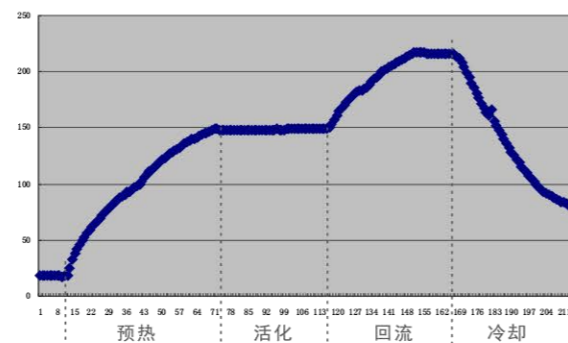
脚踏开关

注 可根据实际需求订制风阻

特点

- 良好的拆焊成功率和拆焊速度。整个流程分6个温区，可根据芯片的工艺要求设置各程序段的工艺参数。使拆焊作业实现标准化。
- 具有10个程序通道，可以分别设置不同的流程参数，以对应不同的拆焊条件。
- 具有密码保护功能，保护设置参数不被擅自修改。
- 数字式温度校准，简单方便。
- 采用大屏幕LCD显示，可显示温度、风量、工作时间等信息。
- 带有真空吸笔，使用方便。
- 温控精准，通过闭环温度控制，使温度稳定度达到 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 。
- 脚踏开关或按键控制拆焊台工作或休眠，简单方便。
- 具有自动冷却及休眠功能，节省能源，同时保护发热体。
- 可以设置工作时间，范围为1-999s。“---”时为连续工作状态。
- 拆除芯片最快只需10s。

性能测试



注 此图为拆焊BGA时，BGA锡球温度变化曲线

测试条件

- 用高温胶带将K型外接传感器固定在BGA中心位置。
- PCB底部不加预热台预热。
- 测试设备为FLUKE2625A。

风量	温度		
	200 $^{\circ}\text{C}$	300 $^{\circ}\text{C}$	450 $^{\circ}\text{C}$
200级风量	205 $^{\circ}\text{C}$	300 $^{\circ}\text{C}$	448 $^{\circ}\text{C}$
6级风量	204 $^{\circ}\text{C}$	300 $^{\circ}\text{C}$	447 $^{\circ}\text{C}$

注 出风量的改变，对温度毫无影响

规格

型号	QUICK 855PG
功率	1300W
温度范围	100~500 $^{\circ}\text{C}$
流量(Max)	75L/Min
风量档位	6~200级
温区	6个
真空吸笔吸力	0.06MPa
流程通道数	10个
发热芯型号	A1155
标配风阻	A1130($\phi 4.4$) / A1121($\phi 6.4$) / A1301($\phi 12.7$)
外形尺寸	250*248*150(mm)
重量	约5.2kg

QUICK/856AX QUICK/856AE 无铅热风拆焊台



注 QUICK856AE不带真空吸笔功能



QUICK856AX手柄示意图

QUICK/856AD 无铅热风拆焊台



注 QUICK856AD不带真空吸笔功能

特点

- 采用无刷涡流风机，气流量可调、范围大，可以适应多种用途。
- 具有CH1、CH2、CH3三个工作通道，并且每个通道的时间、风量、温度可以事先设置，并能通过CH0通道修改。
- 具有密码保护功能和按键锁定功能，保护菜单不被擅自修改。
- 传感器闭合回路，微电脑过零触发控温，功率大，升温迅速，温度调节方便且精确稳定，不受出风量影响。
- 系统设有自动冷风功能，同时采用陶瓷管发热体，发热体寿命超长。
- 实时操作方便，具有自动休眠功能，在休眠状态可以对参数进行设置。
- QUICK856AX自带吸笔功能，操作方便。

规格

型号	QUICK 856AX	QUICK 856AE	QUICK 856AD
功率		1300W	
电压		220V AC	
温度范围		100~500 $^{\circ}\text{C}$	
工作时间范围		1~999s (“---”表示不受工作时间控制，一直处于工作状态)	
流量(Max)		90L/Min	
风量档位		6~200级	
真空压力	600mmHg	-	-
发热芯型号	H616	H616A	A1156
标配风阻	NK1130($\phi 4.4$) / NK2064($\phi 6.4$) / NK2084($\phi 8.4$)		A2064($\phi 6.4$) / A2084($\phi 8.4$) / A2127($\phi 12.7$)
外形尺寸		250*248*150(mm)	
重量	约5.0kg	约4.4kg	约4.4kg

智能无铅拆焊返修台

QUICK/713 维修系统



注 可替换焊咀详见P35页

QUICK/712 维修系统



特点

- 采用无刷涡流风机，气流量无级可调、范围大，可以适应多种用途。
- 系统设有自动大风量冷却功能，延长发热体寿命，保护热风手柄。
- 加热系统采用传感器闭合回路控温，温度精确。
- 设有密码锁定功能，有利于温度参数管控。
- 按键式调温，并设有自动休眠/关机功能。
- 采用数字式温度校准，操作方便。
- 烙铁手柄轻巧，使用舒适。
- 713风枪手柄内置吸笔，使用方便。
- 713内置真空泵，吸力强劲，无须外接真空系统。

规格

型号	QUICK 713	QUICK 712
功率	90W	90W
焊台温度范围	200~480°C	50~500°C
休眠温度范围	200°C	50~200°C
休眠时间范围	0~99min	0~250min
温度稳定度	±2°C(静止空气没有负载)	±2°C(静止空气没有负载)
最高环境温度	40°C	40°C
焊咀接地电阻	<2Ω	<2Ω
重量	约7.9kg	约4.8kg

拆焊台部分	规格	吸锡枪部分(仅713有此功能)	规格
功率	1000W	加热功率	90W
热风温度范围	100~500°C	吸咀温度	200~480°C
流量(Max)	55L/min	吸锡泵	膜片式
风量档位	1~120级	真空压力	600mmHg
最高环境温度	40°C	休眠时间设置范围	0~100min
温度稳定度	±2°C(静止空气没有负载)		

解焊返修台

QUICK/885W 热风枪



特点

- 1800W大功率，升温迅速，K型传感器闭合回路，控温精准。
- 先进的热风加热技术，温度精准均匀。
- 升级无刷电机，低噪音，双涡流出风，风量柔和。
- LCD液晶直观显示，数字化温度校准。
- 关机自动降温保护功能，可延长发热体寿命，更安全。
- 用于热收缩、烘干、除漆、解冻、预热、消毒、焊接、拆焊等。

规格

型号	QUICK 885W
功率	1800W
温度范围	50~600°C
气流量	50L/min(I档,冷风)
	35L/min(II档,热风)
	60L/min(III档,热风)
显示	LCD
分辨率	±1°C
噪音	≤55dB
重量	约1.0kg

解焊返修台



QUICK/2020+ 无铅热风拆焊台



QUICK/2020D+ 无铅热风拆焊台



特点

- 功率750W，升温迅速，热量充足，热效率高。
- 无刷涡流风机降噪设计，无级调速，风量柔和。
- 温度均匀稳定，避免高温损坏热敏感器件。
- 智能休眠，节能环保，延长整机和发热芯等配件使用寿命。
- LCD液晶显示，风量/温度动态直观显示。
- 手柄握感更符合人体工学，轻巧舒适。

规格

型号	QUICK 2020+	QUICK 2020D+
功率	750W	
显示类型	LCD液晶显示	
工作电压	AC 220V	
温度范围	100~500°C	
风量档位	1~100 级	
流量	30L/min (Max)	
三通道存储	/	有
标配风咀	A2025 (φ 2.5) / A2064 (φ 6.4) / A2084 (φ 8.4)	
外形尺寸	98*170*151 (mm)	
重量	约 1.5 Kg	

QUICK/707D+ 双工位维修系统



特点

- 大功率，升温迅速，热量充足，热效率高。
- 风枪采用无刷涡流风机降噪设计，风量柔和，无极调速。
- 焊台采用全金属发热芯，坚固耐用，低压加热，安全省心，分体式焊咀加热，耗材成本低。
- 智能休眠，节能环保，延长整机和发热芯等配件使用寿命。
- 风枪焊台二合一设计，一机多用，节约空间。
- 采用LCD液晶显示，风枪/焊台温度动态直观显示，数字化温度校准。
- 采用全金属烙铁架设计，搭配清洁球，不损伤焊咀。
- 手柄握感更符合人体工学，轻巧舒适。

QUICK/708D+ 双工位维修系统



QUICK/709D+ 双工位维修系统



规格

型号	QUICK 707D+	QUICK 708D+	QUICK 709D+
功率	800W (焊台 70W)	700W (焊台 70W)	1350W (焊台 70W)
显示类型	LCD液晶显示		
工作电压	AC 220V		
焊台温度范围	100~480°C		
风枪温度范围	100~500°C		
风枪温度稳定度	±5°C (静止空气没有负载)		
焊台温度稳定度	±2°C (静止空气没有负载)		
流量	30L/min (Max)	40L/min (Max)	50L/min (Max)
风量档位	10~100 级	1~100 级	
环境温度	0~40°C		
焊咀对地电势	<2mV		
焊咀对地电阻	<2Ω		
标配风咀	A2025 (φ 2.5) / A2064 (φ 6.4) / A2084 (φ 8.4)		A1124 (φ 2.5) / A1130 (φ 4.4) / A1300 (φ 8.4)
焊咀型号	960系列		
外形尺寸	98*170*151 (mm)	180*210*131 (mm)	
重量	约 2.6 Kg	约 3.3 Kg	

解焊返修台



QUICK 957D+ 无铅热风拆焊台

QUICK 959D+ 无铅热风拆焊台

QUICK 862DW+ 无铅热风拆焊台

QUICK 862DA+ 无铅热风拆焊台



特点

- 发热芯特殊合金材料绕制，升温迅速，使用寿命长。
- 无刷涡流风机降噪设计，风量柔和，无极调速。
- 温度均匀稳定，避免高温损坏热敏感器件。
- LCD液晶显示，风量/温度动态直观显示。
- 手柄握感更符合人体工学。
- 智能休眠，自动冷风设计，节能环保，延长整机和发热芯等配件使用寿命。

规格

型号	QUICK 957D+	QUICK 959D+
功率		580W
显示类型		LCD液晶显示
工作电压		AC 220V
温度范围		100~500°C
风量档位		1~100 级
流量		40L/min (Max)
三通道存储	/	有
标配风咀	A1124 (φ 2.5) / A1130 (φ 4.4) / A1300 (φ 8.4)	
外形尺寸	150*180*110 (mm)	
重量	约 1.6 Kg	

特点

- 1000W大功率，升温迅速，热量充足，热效率高。
- 无刷涡流风机降噪设计，无极调速，风量柔和。
- 温度均匀稳定，避免高温损坏热敏感器件。
- LCD液晶显示，风量/温度动态直观显示，温度三通道存储。
- 手柄握感更符合人体工学，轻巧舒适。
- 智能休眠，节能环保，延长整机和发热芯等配件使用寿命。

规格

型号	QUICK 862DW+	QUICK 862DA+
功率		1000W
显示类型		LCD液晶显示
工作电压		AC 220V
温度范围		100~500°C
风量档位		1~120 级
流量		50L/min (Max)
三通道存储		有
钢管出风	直风	旋风
标配风咀	A1124 (φ 2.5) / A1130 (φ 4.4) / A1300 (φ 8.4)	
外形尺寸	180*210*131 (mm)	
重量	约 2.6 Kg	

智能锡焊

烟雾净化

解焊返修

静电防护

测试仪器

BGA返修系统

解焊返修台

QUICK 990A+ 热风拆焊台



QUICK 990AD+ 热风拆焊台



特点

- 发热芯特殊合金材料绕制，升温迅速，使用寿命长。
- K型传感器，闭环控温算法，温度准确稳定，不受风量大小影响。
- 智能冷却，关机延时送风功能，有效保护发热芯和手柄。
- 内置膜片式气泵，双层腔体隔音设计，安静运行风量强劲。
- 手柄握感更符合人体工学，轻巧舒适。

规格

型号	QUICK 990A+	QUICK 990AD+
功率	320W	600W
显示类型	刻度指示	LED数码管
工作电压	AC 220V	
温度范围	150~500°C	100~480°C
流量	24L/min (Max)	
空气泵	膜片式	
外形尺寸	187*245*171 (mm)	
重量	约 3.6 Kg	

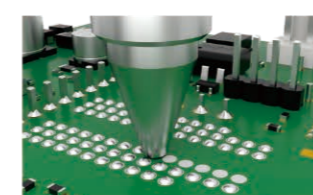
解焊返修台



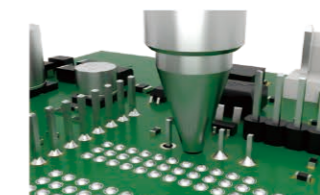
QUICK 201X 吸锡枪



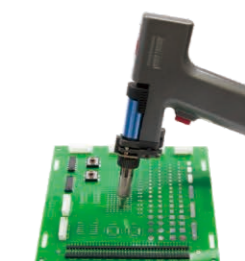
QUICK TV2 吸锡枪



平面除锡



通孔器件除锡



操作示意图

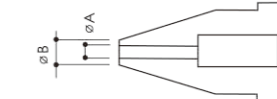
特点

- 内置独特的真空泵，吸力更强劲。
- 加热系统采用传感器闭环回路控温，温度精确。
- 发热体使用低压电源，与电网完全隔离，安全可靠。
- 液晶显示，按键式调温并可设定自动休眠功能。
- 采用数字式温度校准，提高可靠度。
- 吸锡咀及发热管经特别设计，焊锡在熔融状态能被快速吸进过滤器。
- 采用防烫真空软管，防止接触发热部件遭到破坏。
- 静电防护设计，防止因静电及漏电而损坏PCB板。

规格

型号	QUICK 201X		QUICK TV2	
	P/N	ØA (mm)	P/N	ØA (mm)
吸锡泵功率	12V/2A		12V/2A	
加热功率	150W		200W	
吸锡温度	300~480°C		300~500°C	
吸锡泵	膜片式		膜片式	
真空度	600mmHg		650mmHg	
吸咀对地电阻	<2Ω		<2Ω	
吸咀对地电势	<2mv		<2mv	
外形尺寸	180*224*131 (mm)		199*189*135 (mm)	
重量	约4.4kg		约4.5kg	

可更换吸咀



QUICK 201X

P/N	ØA (mm)	ØB (mm)
A1003	1.0	2.0
A1004	0.8	2.3
A1005	1.0	2.5
A1006	1.3	3.0
A1007	1.6	3.0

QUICK TV2

P/N	ØA (mm)	ØB (mm)
AN01-08	0.8	2.3
AN01-10	1.0	2.5
AN01-13	1.3	3.0
AN01-16	1.6	3.0

智能无铅拆焊返修台

QUICK/TS6 镊子烙铁



特点

- 静电防护设计, 精致轻巧。
- 液晶显示, 数字化温度校准。
- 双发热芯同时加热, 快速升温。
- 直接加热贴片器件引脚, 对周边器件无热扩散现象。
- 适合安全快速拆除SMD贴片电阻电容及SOP器件。



TSS06-H	TSS06-J-01-1.5	TSS06-J-02	TSS06-J	
上锡高2mm	上锡高1.5mm	上锡高1.5mm	上锡高1.5mm	
TSS06-0.7H-01	TSS06-1.3H-01	TSS06-1.3H	TSS06-1.6H	TSS06-3.8H-01
上锡高4mm	上锡高2.5mm	上锡高2mm	上锡高2.5mm	上锡高2mm

规格

型号	QUICK TS6
功率	60W
温度范围	100~450°C
温度稳定度	±2°C
手柄型号	TSS60
焊咀型号	TSS06系列
焊咀对地电势	<2mv
焊咀对地电阻	<2Ω
外形尺寸	137*168*114 (mm)
重量	约2.9kg

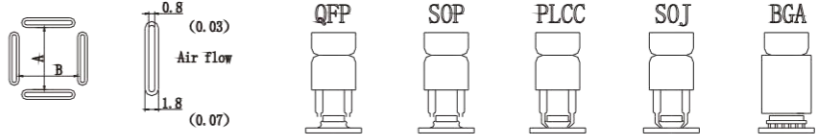
共用风咀



QUICK990D/990/850/855PG

NOZZLES

NOTE
The size in Name/Specification indicates the size of IC package



A1125 QFP 10×10 (0.39×0.39)	A1126 QFP 14×14 (0.55×0.55)	A1127 QFP 17.5×17.5 (0.68×0.68)	A1128 QFP 14×20 (0.55×0.78)	A1129 QFP 28×28 (1.1×1.1)	A1135 PLCC 17.5×17.5 (0.68×0.68) (44 Pins)	A1136 PLCC 20×20 (0.78×0.78) (52 Pins)	
A1137 PLCC 25×25 (0.98×0.98) (68 Pins)	A1138 PLCC 30×30 (1.18×1.18) (84 Pins)	A1139 PLCC 12.5×7.3 (0.49×0.29) (84 Pins)	A1140 PLCC 11.5×11.5 (0.45×0.45) (28 Pins)	A1141 PLCC 11.5×14 (0.45×0.55) (32 Pins)	A1180 BQFP 17×17 (0.67×0.67)	A1181 BQFP 19×19 (0.75×0.75)	
A1182 BQFP 24×24 (0.94×0.94)	A1184 SOJ 18×8 (0.71×0.31)	A1185 TSQJ 13×10 (0.51×0.39)	A1186 TSQJ 18×10 (0.71×0.39)	A1187 SOP 18.5×8 (0.73×0.31)	A1188 PLCC 9×9 (0.35×0.35) (20 Pins)	A1214 SOJ 10×26 (0.39×1.02)	
A1257 SOP 11×21 (0.43×0.83)	A1258 SOP 7.6×12.7 (0.3×0.5)	A1259 SOP 13×28 (0.51×1.1)	A1260 SOP 8.6×18 (0.34×0.71)	A1261 QFP 20×20 (0.78×0.78)	A1262 QFP 12×12 (0.47×0.47)	A1183 SOJ 15×8 (0.59×0.31)	
A1264 QFP 40×40 (1.57×1.57)	A1265 QFP 32×32 (1.26×1.26)	A1263 QFP 28×40 (1.1×1.57)	A1131 SOP 4.4×10 (0.17×0.39)	A1132 SOP 5.6×13 (0.22×0.51)	A1133 SOP 7.5×15 (0.3×0.59)	A1134 SOP 7.5×18 (0.3×0.7)	
A1189 PLCC 34×34 (1.34×1.34)(100 Pins)	A1203 QFP 35×35 (1.38×1.38)	A1215 QFP 42.5×42.5 (1.67×1.67)	A1191 SIP 25L (0.98)	A1192 SIP 50L (1.97)	A1121 Single ø6.4 (0.25)	A1300 Single ø8.4 (0.33)	A1301 Single ø12.7 (0.5)
A1280 BGA24×24 (0.94×0.94)	A1281 BGA26×26 (1.02×1.02)	A1282 BGA31×31 (1.22×1.22)	A1283 BGA38×38 (1.5×1.5)	A1284 BGA41×41 (1.6×1.6)	A1285 BGA44×44 (1.7×1.7)	A1286 BGA15×15 (0.6×0.6)	

注 另可根据实际尺寸订制拆焊QFP、PLCC、BGA等芯片的喷嘴
另855PG可配合风嘴转接头使用N系列BGA风嘴

智能锡焊 烟雾净化 解焊返修 静电防护 测试仪器 BGA返修系统

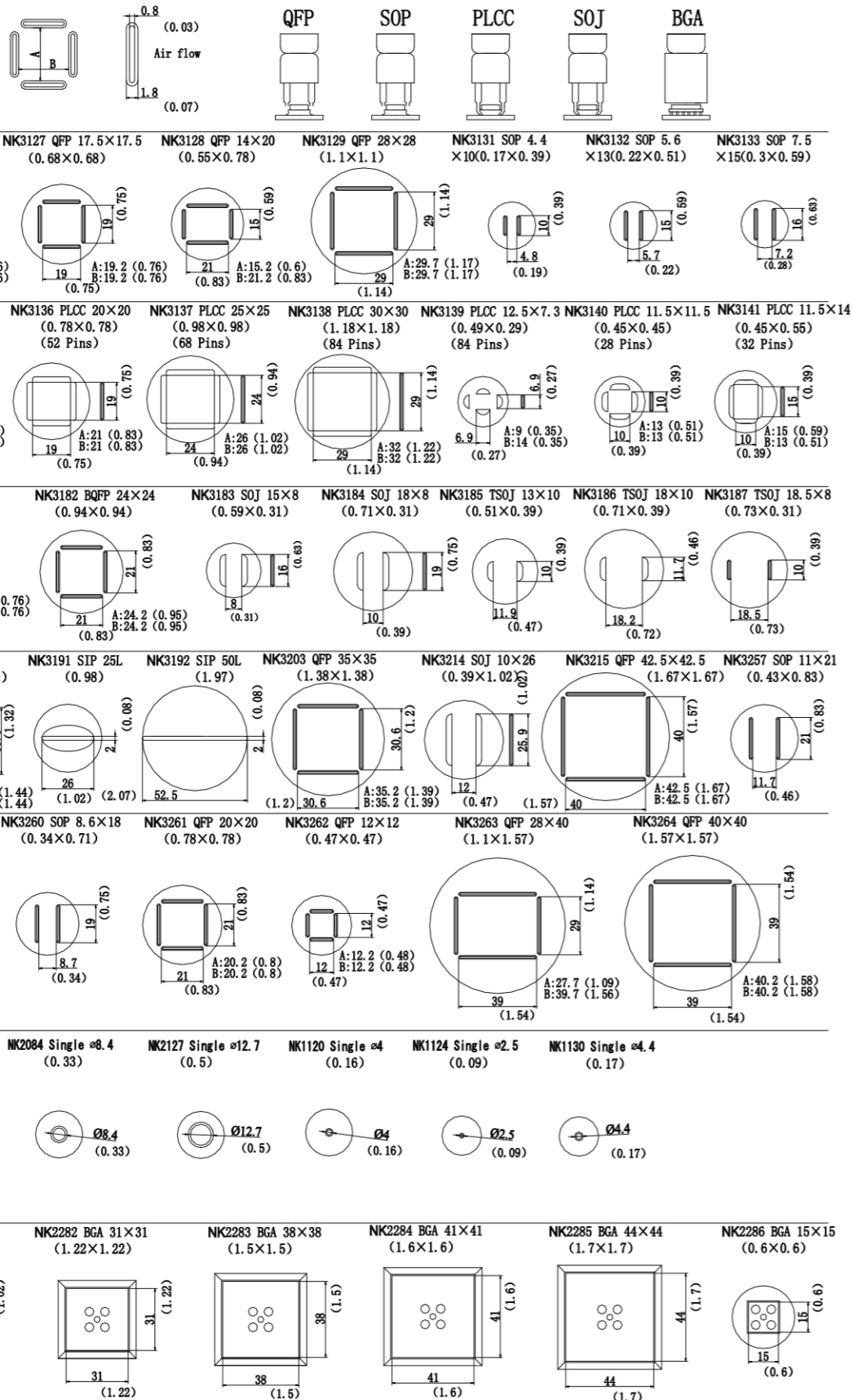
QUICK856AX/AE 861DW /QUICK713

mm (inch)

NOZZLES

NOTE

The size in Name/Specification indicates the size of IC package



QUICK/382A 真空吸放台

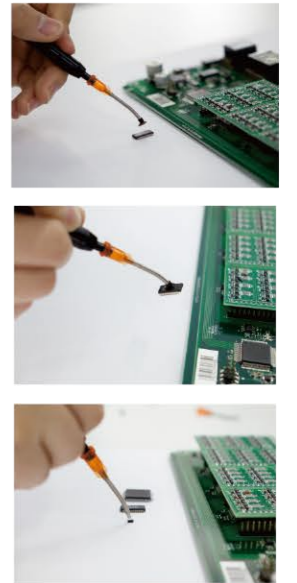


规格

型号	QUICK 382A
功率	10W
真空泵	膜片式
最大真空度	0.03Mpa
吸垫	导电硅橡胶
外形尺寸	161*207*117 (mm)
重量	约2.3kg

特点

- 容易吸取贴片芯片、电阻、电容及各类圆形、微型元件。
- 内置气泵，能够吸取重量达120g的物体。
- 吸咀和吸垫可进行组合使用，且可更换。
- 双工位设计，可同时独立工作。



随机配件

吸放笔	123(L)*10(外径)
软管	1100(L)*6(外径)
直吸咀	内径1.1mm
弯吸咀	内径1.45mm
吸垫	6mm/8mm

注 选配吸咀、吸垫同QUICK381A

QUICK/381A 真空吸放台



规格

型号	QUICK 381A		
功率	15W	吸垫	导电硅橡胶
真空泵	膜片式	尺寸	135*180*111 (mm)
最大真空度	0.06Mpa	重量	约2.0kg

特点

- 静电防护设计，对敏感元件无损害。
- 吸笔人性化设计，结构轻巧。
- 真空吸力可无级调整，单工位设计，吸力强劲，吸力可达180g。
- 能精确有效地控制芯片的吸放，避免释放抖动。
- 脚踏式控制，能有效省电，相对延长使用寿命。
- 吸咀和吸垫可进行组合使用，且可更换。

QUICK/855T+ 自动预热平台



特点

- 红外陶瓷加热体，加热快、效率高、寿命长。
- 温度控制采用K型热电偶，闭合回路过零触发控制，数码管显示，操作简单直观。
- 内置温度测试功能，能方便检测PCB上的温度。
- 可控制外接冷却风扇工作。
- 与QUICK855PG/PX组合使用，可完成SMD及BGA的维修工作。
- 升降臂移动轻巧自如，操作简单。
- 所需加热物体可方便放置于加热窗口上或支架上（另配置）。
- 使用两只开关分别控制电源及加热，在不加热的情况下，也能方便地观察到预热台上的温度。

规格

型号	QUICK 855T+
功率	1600W
加热区面积	260*260 (mm)
加热体材料	陶瓷发热体
温度传感器	K型热电偶
温度范围	50~350°C
温度稳定度	±1°C
环境温度	0~40°C
温度测量范围	室温~600°C
测试精度	±8°C
外形尺寸	350*531*308 (mm)
重量	约13.3kg

返修工作平台组合



注 855PG+855T+组合应用场景

QUICK/853 热风预热台



特点

- 加热迅速，只需10秒可达250°C。
- 内置温度传感器，输出温度稳定。
- 冷热风选择，可预热及冷却芯片。
- 配合拆焊台使用，处理BGA及其他片状IC。

规格

型号	QUICK 853
功率	460W
温度范围	120~250°C
风量	0.18m³/min
外形尺寸	140*186*60 (mm)
出风口直径	40mm
重量	约1.0kg

QUICK/870D 预热 / 回流平台



特点

- CH1、CH2、CH3三通道温度存储，快速切换需要的温度参数。
- 采用特殊加热器，面板温度分布均匀，LCD液晶精准温度显示。
- 可分段设置温度，预热温度/回流温度独立设置，程序自动控制。
- 轻触按键软件启动加热，寿命优于传统机械开关。
- 数字化温度校准，方便快捷，温度更精准。
- 数据通讯，可实现自动化联动控制。
- 外接K型传感器，实时监控产品的实际温度。

规格

型号	QUICK 870D
功率	800W
加热板面积	180*200 (mm)
加热板材料	铝
温度传感器	K型热电偶
温度范围	50~350°C
环境温度	0~40°C
温度稳定度	±1°C
外形尺寸	293*357*67 (mm)
重量	约5.1kg

QUICK 854D 红外预热台



特点

- 暗红外陶瓷加热体，加热快、效率高、寿命长。
- 自带温度测试功能，方便检测PCB温度。
- 温度记忆功能，三通道设置，快速切换温度。
- 传感器闭合回路PID控制，温度精确稳定。
- 可用于线路板的预热及其他需要整体均匀加热的工艺。
- 有通讯接口，可与其他设备通讯联机控制。

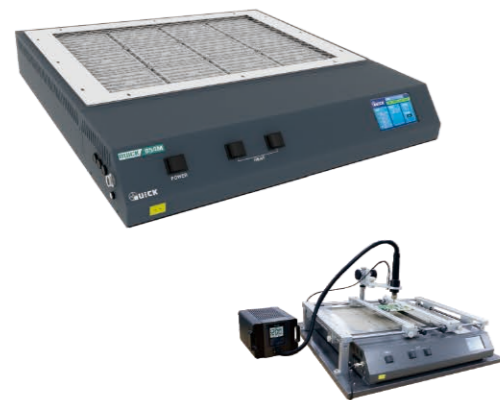
QUICK 854H 红外预热台



特点

- 高红外发热，加热快，效率高。
- 自带温度检测功能，方便检测 PCB 实际温度。
- 温度记忆功能，三通道设计，快速切换温度。
- 传感器闭合回路 PID 控制，温度精准稳定。
- 耐高温玻璃表面，方便维护和使用。
- 可用于线路板预热及其他需要整体均匀加热的工艺。
- 有通讯接口，可与其他设备通讯联动控制。

QUICK 854M 红外预热台



注 TR1300+854M组合应用场景

规格

型号	QUICK 854D	QUICK 854H	QUICK 854M
功率	400W	1300W	4800W
加热区域面积	130*130 (mm)	191*235 (mm)	350*500 (mm)
加热体材料	陶瓷加热体	碳纤维发热管	陶瓷加热体
温度传感器	K型热电偶	K型热电偶	K型热电偶
温度范围	50~350°C	50~350°C	50~450°C
温度计测试范围	0~600°C	0~600°C	0~600°C
使用环境温度	0~40°C	0~40°C	0~40°C
温度稳定度	±1°C	±1°C	±1°C
外形尺寸	203*271*65 (mm)	293*357*65 (mm)	1220*750*400 (mm)
重量	约2.2kg	约5kg	约55kg

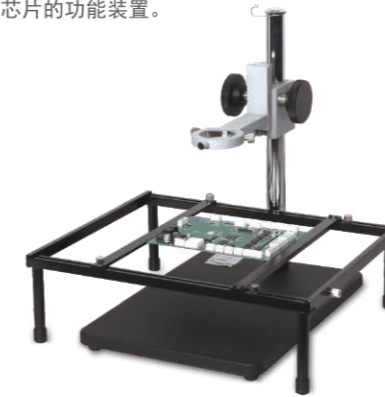
QUICK 800 系列返修支架

特点

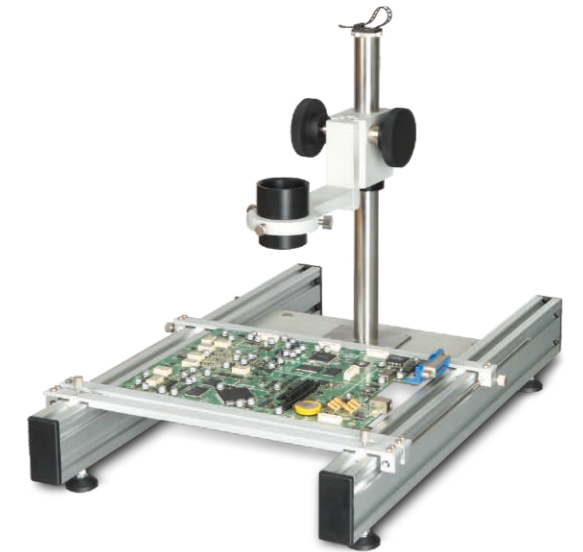
- 全新组合式工作平台，使维修更加方便。
- 上下同时加热，特别适合拆取BGA及其它需要进行预热工序的芯片。
- 可根据线路板尺寸大小的不同进行调节。
- 可根据需要选择真空吸放芯片的功能装置。



QUICK 800S支架组件



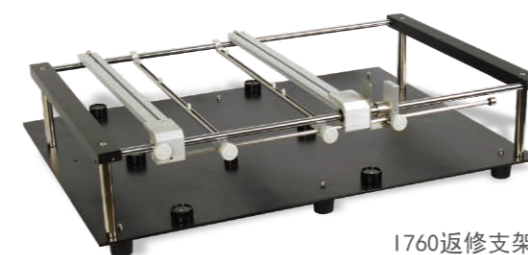
QUICK 800L支架



QUICK 800A支架

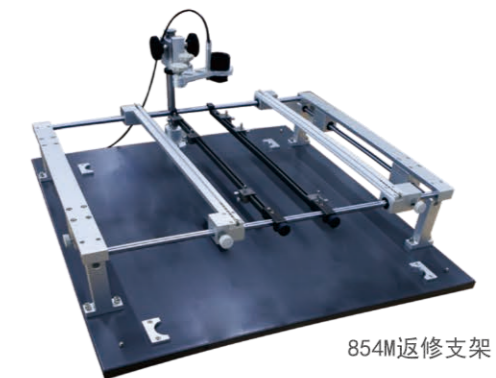
型号	QUICK 800S	QUICK 800L
800支架尺寸	224*180*82 (mm)	393*300*85 (mm)
重量	约3.5Kg	约3.8Kg

型号	QUICK 800A
外形尺寸	517*340*380 (mm)
最大线路板尺寸	350*280 (mm)
高度	200mm
微调高度	60mm
重量	约4.3Kg



1760返修支架

QUICK 1760支架	
最大线路板尺寸	420*400 (mm)
可配预热台	855T+
重量	20kg



854M返修支架

QUICK 854M支架	
最大线路板尺寸	500*450 (mm)
可配预热台	854M
重量	20kg